

2021.09.21 新製品リリース

## 半導体パッケージの回路微細化に対応する Φ30μm径対応ボールマウンタシステムの販売開始のお知らせ

AIメカテック株式会社(本社:茨城県龍ヶ崎市向陽台、社長:阿部 猪佐雄)は、半導体事業の新たな提案として、新製品「Φ30μm径対応ボールマウンタシステム」の販売を開始します。

本システムは半導体パッケージの回路微細化に対応するため、当社コア技術の一つであるインクジェット技術を応用し開発したシステムです。フラックス印刷工程を、マスク版を使用した従来工法ではなく、インクジェット技術を適用することで均一塗布が実現でき狭ピッチ化への適用が可能となりました。このFlux-IJP装置と従来の高精度はんだボール搭載装置及び高速検査リペア装置を含め、トータルソリューションとしてΦ30μm径はんだボール実装を実現しています。(特許取得済)

当社インクジェット技術は、フラットパネル市場を中心に多くのお客様にご採用頂いております。長年培ったインクジェット技術を応用し、半導体パッケージ実装工程における更なる微細化への対応を実現していきます。

5G通信、ビッグデータ、IoT及びAIなどを背景にデータセンター、モバイル機器及び車載用途など半導体パッケージの需要は拡大しております。同時に、高速・高機能化及び小型化に伴う回路微細化、ボール小径化への対応が求められております。特に先進半導体パッケージではそのニーズが極めて高く、本システムの採用が検討されています。

弊社は、今後も製造プロセスのイノベーションを通してより便利で豊かな生活スタイルの向上により社会に貢献できる企業を目指して参ります。

### お問い合わせ

AIメカテック株式会社

営業部 TEL:0297-62-9119

<https://www.ai-mech.com/newproducts/>



Φ30μm径対応ボールマウンタシステム(外観)